

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2025-017

福州达华智能科技股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：截至目前，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司存在对资产负债率超过 70%以上的控股子公司提供担保，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联担保情况概述

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，福建福米科技有限公司（以下简称“福米科技”）系公司参股公司，公司持股比例为 48.41%，由于公司持股 5%以上股东陈融圣先生现担任福米科技董事长兼法人，董事、总经理兼董事会秘书张高利先生现担任福米科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，福米科技为公司关联方。

为了福米科技的正常业务运营及发展，公司拟对福米科技提供 100,000 万元的额度担保。福米科技其他股东按相应持股比例提供担保，上述担保有效期为 2024 年度股东大会审议通过后十二个月。

本次事项构成关联交易，公司董事会在表决本次关联交易事项时，关联董事张高利先生已回避表决，会议以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，该议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。本次关联交易事项在董事会审议通过后，

尚需提交股东大会审议，关联股东陈融圣先生、张高利先生将在股东大会上回避表决。本次关联交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不会构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

截至2025年4月24日，公司对福米科技提供担保金额合计39,456.66万元。
明细如下：

担保方	被担保方	综合授信银行	持股比例	被担保方最近一期（截至2024年12月31日）资产负债率	最高额担保额度（万元）	公司按原持股比例提供的担保额度（万元）	截至2025年4月24日担保余额（万元）	担保额度占上市公司最近一期（截至2024年12月31日）净资产比例	是否为关联担保
公司	福米科技	海峡银行鼓楼支行	48.41%	50.00%	160,000	81,600	31,041.66	197.25%	是
公司	福米科技	中国银行福州分行	48.41%	50.00%	19,800	10,098	8,415.00	24.41%	是
合计					179,800	91,698	39,456.66	221.66%	--

公司于2024年9月9日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（一）的议案》《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》，公司对福米科技的持股比例已由51%降至48.41%，但上述借款在福米科技为公司控股子公司时已实质发生，所以上述担保均为公司按持股比例51%提供担保，福米科技其他股东按相应持股比例49%提供担保。后续若有新增借款，公司拟按照持有的福米科技的股权比例为其新发生借款提供担保，福米科技其他股东按相应持股同比例提供担保，担保费由董事会授权管理层根据市场情况确定。

二、被担保人（关联方）基本情况

（一）福建福米科技有限公司

1、名称：福建福米科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350182MA8TDRTH63

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址：福建省福州市长乐区湖南镇鹏旺路 27 号

5、法定代表人：陈融圣

6、成立日期：2021 年 06 月 16 日

7、注册资本： 147,500 万元人民币

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子专用材料制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、财务状况：截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额 269,293.01 万元、负债总额 134,656.58 万元、净资产 134,36.43 万元，资产负债率 50.00%；营业收入 42,451.09 万元，净利润-12,356.79 万元。（经审计）

截止 2025 年 3 月 31 日，资产总额 268,912.59 万元、负债总额 136,905.08 万元、净资产 132,007.52 万元，资产负债率 50.91%；营业收入 6,387.05 万元，净利润-2,628.72 万元。（未经审计）

10、股权结构：公司持有其 48.41%股权，福州新投创业投资有限公司持有 46.51%股权，炎武实业发展（上海）有限公司持有其 5.08%股权，福米科技无实际控制人。

11、与上市公司的关联关系：由于公司持股 5%以上股东陈融圣先生现担任福米科技董事长兼法人，董事、总经理兼董事会秘书张高利先生现担任福米科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，福米科技属于“由上市公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）”，

福米科技为公司的关联法人。

截至本公告披露日，福米科技不是失信被执行人。

三、担保（关联交易）的主要内容和定价政策

本次不涉及保证合同的变更和重新签订。截至 2025 年 4 月 24 日，公司已实际对福米科技提供担保金额合计 39,456.66 万元，上述担保为公司在 2024 年 9 月 9 日第四届董事会第二十九次会议审议福米科技增资事项前向银行申请借款而提供连带责任的担保。后续若有新增借款，公司拟按照持有的福米科技的股权比例为其新发生借款提供担保，福米科技其他股东按相应持股同比例提供担保，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容以签订的具体合同为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次提供担保是为了满足参股公司的生产经营以及流动资金周转的需要，此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，有助于保障参股公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益，不存在损害公司和股东利益的行为，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、董事会意见

经过公司董事会认真核查，认为：本次关联担保事项是为了福米科技的正常业务运营及发展，公司拟继续对福米科技已经发生的借款提供担保。后续若有新增借款，公司拟按照持有福米科技的股权比例为其新发生借款提供担保，福米科技其他股东按相应持股比例提供担保。以上是为了确保福米科技业务的持续稳定，维护福米科技日常经营的有序开展，亦符合公司的整体发展需要。本次关联担保对象福米科技的生产经营稳定，资信状况良好，具有良好的履约能力，风险相对可控，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。

六、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司独立董事召开了 2025 年独立董事第一次专门会议，全票审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，一致同意将《关

于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事本着独立客观的原则，认真审阅了公司提交的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为：本次关联担保事项是为了福米科技的正常业务运营及发展，公司拟继续对福米科技已经发生的借款提供担保。后续若有新增借款，公司拟按照持有的福米科技的股权比例为其新发生借款提供担保，本次关联担保不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年初至本公告披露日，公司与福米科技及其子公司发生采购原材料、租赁关联人房屋、向关联人提供劳务、向关联人销售产品等日常关联交易，详见公司于同日披露的《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度为 175,000 万元，占截止 2024 年 12 月 31 日经审计的归母净资产（41,368.98 万元）的 423.02%，截止 2025 年 4 月 24 日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 49,683.2 万元，占截止 2024 年 12 月 31 日经审计的归母净资产（41,368.98 万元）的 120.10%。其中，公司对合并报表外单位（福米科技）提供担保总余额为人民币 39,456.66 万元，占截止 2024 年 12 月 31 日经审计的归母净资产（41,368.98 万元）的 95.38%。

公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

九、备查文件

《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《福州达华智能科技股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日